



LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、 _________ 殿 に納入する ______ miniSDソケットコネクタ について規定する。 This specification covers the miniSD SOCKET CONNECTOR series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product	t Name	製品型番 Part Number
ヘッダーアセンブリー Header Assembly	【無鉛】 (Lead Free)	500972-1109
エンボス梱包品 Embossed Package	【無鉛】 (Lead Free)	500972-1107

【3. 定格 RATINGS】

項目Item	月	Standard				
最大許容電圧 Rated Voltage (MAXIMUM)	10 V	[AC(実劾値_rms)/ DC)				
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.5 A					
使用温度範囲 Ambient Temperature Range	-25°C	-25°C ~ +85°C * ¹				
使用湿度範囲 Ambient Humidity Range	95%R.H.	. MAXIMUM * ²				
保存温度範囲 Storage Temperature Range	+5°C	∼ +35°C				
保存湿度範囲 Storage Humidity Range	85%R.H.	. Maximum * ²				
*1:通電による温度上昇分も含む。	Including terminal temperature rise	9.				
REV. C SHEET 1~14						
REVISE ON PC ONLY	TITLE:					
C 家更 REVISED J2006-0835 '05/09/13 K.YAMA	MINISD S (N NE THIS DOCUMENT CONTAINS IN	miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) <u>製品仕様書</u>				
REV. DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT B	BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DESIGN CONTROL ST	ATUS WRITTEN CHECKED BY: BY: K.YAMANE M.YAGI J	APPROVED DATE: YR/MO/DAY BY: 2004/07/14				
DOCUMENT NUMBER		FILE NAME SHEET				
PS-500972-001		PS-500972-001.doc 1 OF 14				
		EN-37(019				





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【4. 性能 PERFORMANCE】

<u>4-1. 電気的性能 Electrical Performance</u>

	項 Iten			条 件 Test Condition	規 Requir	
4-1-1	1 指	· 经触抵抗 Contact esistance	短絡電流10mA以 (JIS C5402 5.4)	嵌合させ、開放電圧20mV以下、 下にて測定する。 d, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM,	100 mil MAXI	liohms
4-1-2	² In	絶縁抵抗 sulation esistance	隣接するターミナ DC 500Vを印加し (JIS C5402 5.2/N	1IL-STD-202 試験法 302) between adjacent terminals	1000 Me MINII	0
4-1-3	3 D	耐電圧 ielectric Strength	 (JIS C5402 5.2/N 隣接するターミナ AC 500V (実効値 (JIS C5402 5.1/N Apply 500V AC for and ground. 	ILI-STD-202 Method 302) トル間及びターミナル、アース間に かを1分間印加する。 IIL-STD-202 試験法 301) or 1 minute between adjacent terminals IIL-STD-202 Method 301)	異常な No Brea	
			(the ca	ard thickness 1.4mm, the card pad thickness 1.		company
			(the ca See pa	ard thickness 1.4mm, the card pad thickness 1. aragraph 6.		company
	F	REVISE ON	(the ca	ard thickness 1.4mm, the card pad thickness 1.	2mm).	company
	C		(the ca See pa	TITLE: miniSD SOCKET CON (NORMAL TYPE	^{2mm).} NECTOR ⊇) 製品仕様	
		SEE SI	(the ca See pa	TITLE: miniSD SOCKET CON	2mm). NECTOR 王) <u>製品仕様</u> IS PROPRIET/	۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲
	C REV. JMENT N	SEE SI	(the ca See pa I PC ONLY HEET 1 OF 14 SCRIPTION	TITLE: miniSD SOCKET CON (NORMAL TYPE) THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT	2mm). NECTOR 王) <u>製品仕様</u> IS PROPRIET/	۲. To ARY TO





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

EN-37-1(019)

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

	項目			条件			規格	
Item				Test Condition		Requirement		
4-2-1	Termi	全具保持力 nal, Nail ion Force	毎分25±3mmの 金具を軸方向に引 Apply axial pull of speed rate of 25=	張る。 ut force at t	he		N MINIMUM / F gf MINIMUM / F	
4-2-2	Inse	なび抜去力 ertion / wal Force	毎分25±3 mmの ダミーカードを排 Push the dummy at the speed rate 25±3 mm/minute	速さで 甲す。 card of	カムロック荷重 Lock Force カムロック 解除荷重 Lock Release Force	カ ー	4.9~13.8 N {0.5~1.4 kgf} 4.9~13.8 N {0.5~1.4 kgf} ドが飛び出すこ ischarge the ca	
4-2-3	Fo	乗理抜き力 orced drawal	ダミーカードをオ 毎分25±3mmの 但し、ダミーカー 使用する。 Pull the dummy of at the speed rate But, the dummy of	速さで引き - ドは未挿打 card out of t of 25±3 m card use a u	抜く。 友カードを he lock position m/minute.	初回 First time	2.0 N MII	NIMUM
	RE	VISE ON F	PC ONLY	TITLE:				
	RE C		PC ONLY EET 1 OF 14	THIS DOO	(NC	ORMAL TY	製品仕様	RY TO
		SEE SH		THIS DOO	(NC	ORMAL TY	PE) <u>製品仕様</u> IAT IS PROPRIET <i>I</i>	RY TO





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

<u>4-3. その他 Environmental Performance and Others</u>

(プ 4-3-1 Re	繰り返し挿抜 プッシュイン / プッシュアウト) epeated Mate / Un-mate (Push in / Push out) 温度上昇 Temperature Rise 耐振動性 Vibration	ダミーカードで、1時間に400~600回の速さで、 挿入・抜去を10,000回繰り返す。尚、2000回毎 にカードを交換する。 Insertion and extraction are repeated 10,000 cycles with the dummy card at the speed rate of 400 - 600 cycles/hour. Exchange the dummy card every 2000cycles. 電流を通電し、コネクタの温度上昇分を 測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498) ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向に周波数10~55~10 Hz/分、 全振幅1.52mmの振動を各2時間加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Mate dummy card and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test.	接触抵抗 Contact Resistance 挿入力及び 抜去力 Insertion / Withdrawal	quirement 140 milliohms MAXIMUM ダミーカードで測録 With the dummy card 4-2-2項満足のこと (1000回毎に測定) Must meet 4-1-3 (Measure every 1000cycles) 異常なきこと No Damage 30 °C MAXIMUM 異常なきこと No Damage
	Temperature Rise 耐振動性	測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498) ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向に周波数10~55~10 Hz/分、 全振幅1.52mmの振動を各2時間加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Mate dummy card and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes,	Temperature Rise 外 観 Appearance 接触抵抗 Contact	異常なきこと No Damage 140 milliohms
4-3-3		通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向に周波数10~55~10 Hz/分、 全振幅1.52mmの振動を各2時間加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Mate dummy card and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes,	Appearance 接触抵抗 Contact	No Damage
4-3-3		Mate dummy card and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes,	Contact	
		hassing DL. The during the test		
<u>.</u>		Amplitude: 1.52 mm P-P Frequency: 10-55-10 Hz Shall be traversed in 1 minute. (MIL STD-202 Method 201)	瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM
	REVISE ON F	miniSD S0		
С		THIS DOCUMENT CONTAINS IN	FORMATION THAT	製品仕様書 IS PROPRIETARY TO
REV.		CRIPTION INCLEA INC. AND SHOULD NOT BE		
	T NUMBER PS-500972-	001		SHEET 1 OF 14 4 OF 1





LANGUAGE

					ENGLISH
項目 Item T			条件 Test Condition		見 格 uirement
		通電状態にて、 6方向に490m/s ² (を合させ、DC 1mA そ合軸を含む互いに垂直な (50G) の衝撃を各3回加える。 7/MIL-STD-202 試験法 213)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-4	動撃性 hock	shock conditions. applied along 3 m	d and subject to the following 3 shocks shall be nutually perpendicular axes, current during the test.	接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
		(Total of 18 Shoc Test pulse: H Peak value: 49 Duration: 17		瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM
		相対湿度90~95%	6合させ、40±2℃、 6の雰囲気中に96時間 1~2時間室温に放置する。	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-1-7	·湿性 midity	of 40±2°C, relati	d and subject to the conditions ve humidity 90-95% n completion of the exposure	接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
		period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.		耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
		9サイクル行い、	を合させ、第7項に示す条件にて 10サイクル目は段階6迄の ノ、段階7aは初めの9サイクル	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
		のうち任意の5サ 室温に24時間放置 (MIL-STD-202 討		接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
4-3-6 Mo	サイクル isture istance	specified on per. specimens shall b	d and subject to the conditions [7] for 9 cycles. The test be exposed to STEP 7a of 9 cycles. A 10th cycles	耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
		performed, after	step 1 through 6 is then which the test specimens led at ambient room conditions	絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MINIMUM
RE	VISE ON I	PC ONLY	TITLE:		
C SEE SHEET 1 OF 14		(NC		製品仕様書	
REV.		CRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INF MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE		
				FILI	E NAME SHEET
DOCUMENT NU PS-	MBER 500972	-001			
					^{1EET 1 OF 14} 5 OF 14 FN-37-1(019)





LANGUAGE

	項目			~ 在		規格	
	Item			条件 Test Condition	Re	equirement	
	泪曲		+85±2°Cに30分 5サイクル繰り返 3分以内とする。 放置する。 (JIS C0025)	☆合させ、-55±3℃に30分、 、これを1サイクルとし、 す。但し、温度移行時間は 試験後、1~2時間室温に d and subject to the following	外 観 Appearance	異常なき	
4-3-7	Tem	サイクル perature ycling	the exposure per shall be condition for 1 to 2 hours, a measurements sl 1 cycle a) -55± b) +85±	ycles. Upon completion of iod, the test specimens ned at ambient room conditions after which the specified nall be performed. 3°C • • • 30 minutes 2°C • • • 30 minutes be within 3 minutes.	接触抵抗 Contact Resistance	140 milli MAXIM	
	T	持熱性	ダミーカードを制 96時間放置後取 ^し 放置する。 (JIS C 60068-2-2	残合させ、85±2℃の雰囲気に り出し、1~2時間室温に /MIL-STD-202 試験方法 108)	外 観 Appearance	異常なき No Dan	
4-3-8 Heat Resistance for 96 hours period, the t at ambient i after which shall be per		for 96 hours. Upc period, the test sp at ambient room after which the sp shall be performed	d and exposed to 85±2°C on completion of the exposure becimens shall be conditions conditions for 1 to 2 hours, becified measurements ed. /MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	140 milli MAXIN		
	96時間放置後取 放置する。		ダミーカードを嵌合させ、-40±2℃の雰囲気に 96時間放置後取り出し、1~2時間室温に 放置する。 (JIS C 60068-2-1)		外 観 Appearance	異常なき No Dan	
4-3-9 Cold Resistance for 96 hours. Upo period, the test s at ambient room			接触抵抗 Contact Resistance	140 milli MAXIN			
	C RI	EVISE ON I SEE SH	PC ONLY EET 1 OF 14		DCKET CON DRMAL TYPI	^{E)} 製品仕様	
R	EV.	DES	CRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE			
OCUM					FI	ILE NAME	SHEE
	DC	-500972 ⁻	-001		000	SHEET 1 OF 14	6 OF 1





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

EN-37-1(019)

Solderability bib colder talls into the month colder		-			
4:3-10 単品級ガス SO ₂ Gas ダミーカードを検合させ、40±2°C、 相対温度75%にて10±50pmの更硫酸ガス中に、 のる問助と買する。 外 額 Appearance 異常なきこと No Damage 4:3-10 正品級ガス SO ₂ Gas Mate dummy card and expose to 10±5 ppm SO ₂ gas, ambient temperature 40±2°C, Table to Humdiny 75% for 96 hours. J40 milliohms Contact Resistance 140 milliohms MAXIMUM 4:3-11 「塩水噴霧 Salt Spray ダミーカードを絞合させ、35±2°C1C 5±1% 量量にの加速のないたいた。 Walk dummy card and exposed to the following att mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dp in numing water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Solder Solder (meld at 230±5°C) up to 0.5mm from the tip of tails for 3±0.5 sec. J40 milliohms MAXIMUM 4-3-12 半田付け性 Solderability Dip solder tails into the molten solder (neld at 230±5°C) up to 0.5mm from the tip of tails for 3±0.5 sec. 漏れ性 Solder Wetting Watel the solder Wetting J30% of immersed area must show m volds, Pinholes THE Miss Contact Concentration: 5±1% Solder TITLE: minitSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) J82m fab 90% of immersed area must show m volds, Pinholes 4:3-12 EE SHEET 1 OF 14 Rev. TITLE: TITLE: TITLE: TITLE: TITLE: J22m fab 90% of immersed area must show m volds, Pinholes					
SO2_Gas Mate dummy card and expose to 10±5 ppm SO_2 gas, ambient temperature 40±2°C, relative humidity 75% for 96 hours. 指参照結抗 Contact Resistance 140 milliohms MAXIMUM ダミーカードを扱合させ、35±2°C1Cで 5±1% 電量比の塩水を44時間課題し、 試験後、常温で水洗いした後、室温で 乾燥させる。 (MLSTD-1344) メ 和pearance メ 親市なさこと No Damage 4-3-11 塩水噴霧 Salt Spray Mate dummy card and exposed to the following shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. Concentration: 5±1% Spray time: 48 hours Ambient temperature: 35±2°C 140 milliohms MAXIMUM 4-3-12 半田付け性 Solderability Sit to the molten solder (heid at 230 ±5°C) up to 0.5mm from the tip of tails for 3±0.5 sec. 湯れ性 Solder Wetting 3@ おれ性 Solder Wetting 3@ おれ性 Solder Wetting 3@ おん the spray time: Site Start Spray TITLE: MLEXED NEED NEED NEED NEED NEED NEED NEED	西広酔ガス	ダミーカードを 相対湿度75%にて	渋合させ、40±2℃、 〔10±5ppmの亜硫酸ガス中に	外観	異常なきこと
4-3-11 塩水噴霧 Salt Spray Mate dummy card and exposed to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period. Salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48 hours Ambient temperature: 35±2°C 接触抵抗 Contact Resistance 140 milliohms 4-3-12 半田付け性 Solderability 端子先端より0.5mmの位置まで230±5°Cの 半田に3±0.5秒浸す。 濡れ性 Solder 浸渍面積の 90%以上 90% of immersed (held at 230.5b% z) 湯水桃性 Solder 90% UL 90% of immersed wetting 90% UL 90% of immersed wetting 4-3-12 半田付け性 Solderability Tittle: miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 90% of immersed area must show no voids, Pinholes EE SHEET 1 OF 14 REV. Titls Document contrains information that is Broomet are presented to be contrains information that is Broomet are to be shown to without written persmission voides Nic. AND Should not be used without written persmission pocument number This Document contrains information that is Broomet are to be shown to voide information that is Broomet are to be shown to voide the shown to be used without written persmission	SO ₂ Gas	SO ₂ gas, ambient relative humidity ダミーカードを使 5±1%重量比の均 試験後、常温でか 乾燥させる。	t temperature 40±2°C, 75% for 96 hours. 反合させ、35±2°Cにて 塩水を48時間噴霧し、	Contact Resistance 外観	MAXIMUM 異常なきこと
4-3-12 半田付け性 Solderability 当 solder tails into the molten solder (held at 230±5°C) up to 0.5mm from the tip of tails for 3±0.5 sec. 濡れ性 Solder Wetting 90%以上 90% 以上 90% of inmersed area must show no voids, Pinholes REVISE ON PC ONLY TITLE: miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) C SEE SHEET 1 OF 14 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION DOCUMENT NUMBER THE NAME	4-3-11	Mate dummy care salt mist condition of the exposure p shall be removed in running water, measurements sh NaCl solution Concentration: Spray time: Ambient tempera	ns. Upon completion beriod, salt deposits I by a gentle wash or dip after which the specified hall be performed. 5±1% 48 hours	Contact	
C SEE SHEET 1 OF 14 miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) REV. DESCRIPTION 社林書 DOCUMENT NUMBER FILE NAME SHEE	4-3-17	半田に3±0.5秒浸 Dip solder tails in (held at 230±5°C	長す。 to the molten solder C) up to 0.5mm from the tip	Solder	90%以上 90% of immersed area must show no
C SEE SHEET 1 OF 14 miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) REV. DESCRIPTION 社林書 OCUMENT NUMBER FILE NAME SHEE	Solderability	(held at 230±5°C	C) up to 0.5mm from the tip		area must show no
C SEE SHEET 1 OF 14 (NORMAL TYPE) REV. DESCRIPTION THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION POCUMENT NUMBER FILE NAME SHEE					
DOCUMENT NUMBER FILE NAME SHEE	REVISE ON	PC ONLY			IECTOR
	_		miniSD SC (NC) THIS DOCUMENT CONTAINS INF	ORMAL TYPE) 製品仕様書 S PROPRIETARY TO





LANGUAGE

項 目 Item		条 件 Test Condition	F	規格 Requirement	
4-3-13 半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	リフロー半田付(下記プロファイ) Performed to the 赤が <u>Infrat</u> 260°C以上 MIN. 平均温度勾配: 1 Average range to sec.M 100 秒以- (予熱: 170~ Pre-heat ter 注 <u>TEMPERAT</u>	tの温度と時間は レで行う。 following condition. A線リフロー条件 red reflow condition 3秒以下 (ピーク温度) secMAX.(Peak temperature) .8°C/s以下 p: MAX. (225°C以上) MIN. (225°C以上) MIN.	外 観 Appearanc	リフロー 端子ガタ 異常な	、割れ等 きこと mage times
	IEET 1 OF 14			PE) <u>製品仕様</u> AT IS PROPRIET/	ARY TO
REV. DES	CRIPTION			FILE NAME	SHEET
PS-500972	-001		SE	E SHEET 1 OF 14	8 OF 14
				EN-	37-1(019)



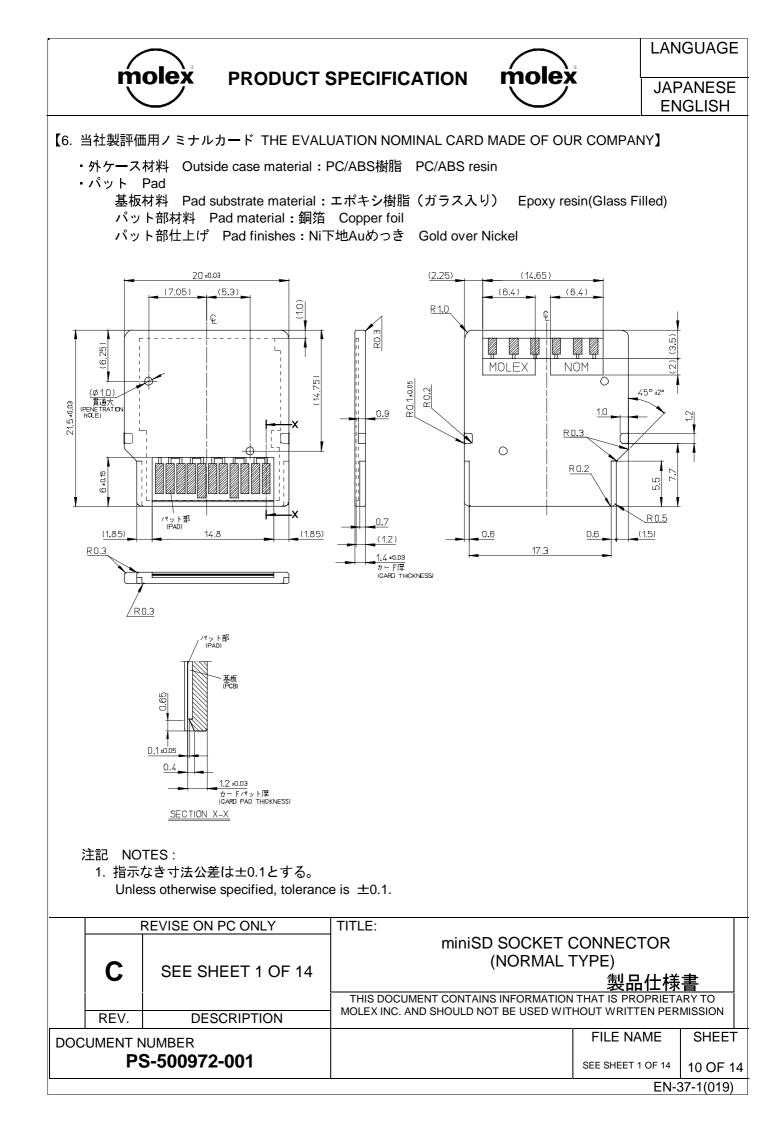


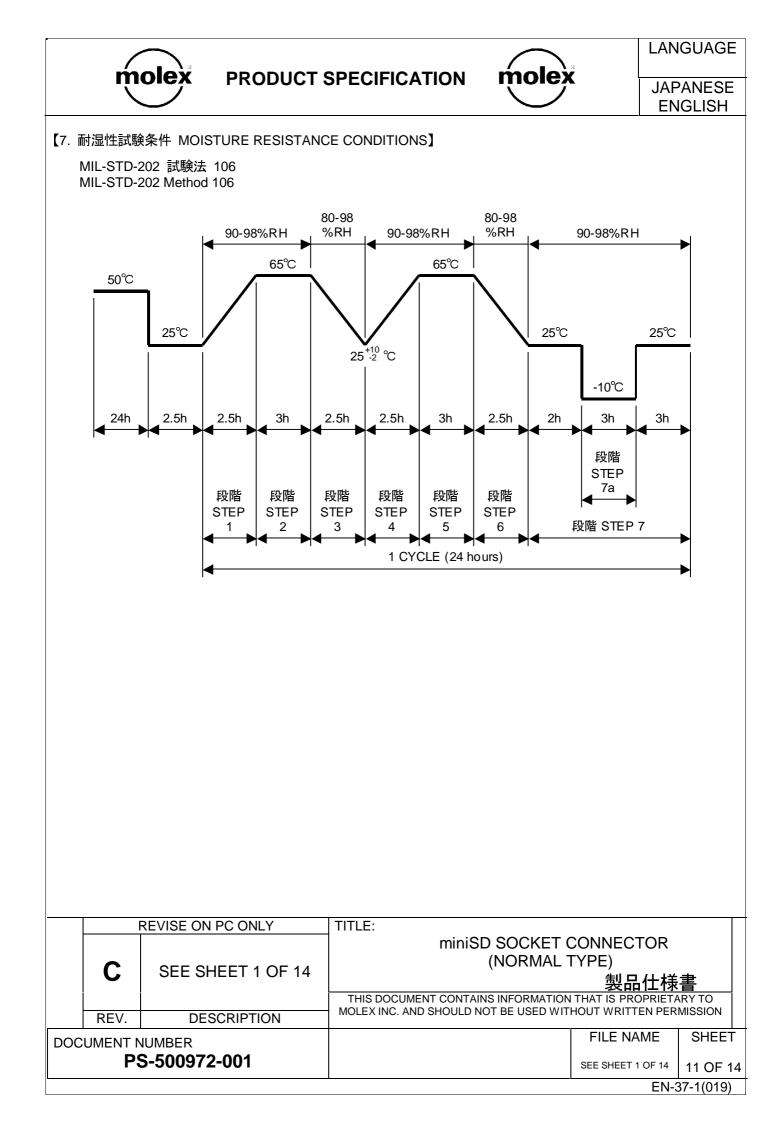
LANGUAGE

JAPANESE FNGLISH

EN-37-1(019)

	\bigcirc			\bigcirc	E	NGLISH	
	項 目 Item		条件				
4-3-1	手半田耐熱性 Resistance to Soldering Iron Heat	ターミナルにある 異常な加圧のない Touch the termin (held at 350±10	850±10℃で3±1秒間 てる。但し、ターミナルに いこと。 nal with the soldering iron ℃) for 3±1 seconds. t too much pressure to	外 眷 Appeara	著しいガ 電気的 機械的 異状な のf produ of produ or exe loosene term Electr Mech charao	-ルなどの タがなく、 対性能に 対性能に さきこと leformation uct shape cessive ess of the ninals. ical and nanical cteristics satisfied.	
				():	参考規格		
				()	Reference Star	ndard	
	回参照 Refer to the	面参照 Refer to the drawing.					
	REVISE ON	PC ONLY	TITLE:	SOCKET	ONNECTOR		
	C SEE SH	IEET 1 OF 14	(NORMAL T	YPE) <u>製品仕椅</u>		
	REV. DES	CRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS MOLEX INC. AND SHOULD NO				
DOCU		001			FILE NAME	SHEET	
	PS-500972	-001			SEE SHEET 1 OF 14	9 OF 14	









JAPANESE ENGLISH

【8. 使用上の注意事項 APPLICATION NOTES 】

8-1. カード抜け防止

Card omission prevention

本品にはカード抜け防止用の簡易ロックをカムスライダーに設けていますが、カードを嵌合した状態で 落下させたり、衝撃を加えるとカードが抜けてきます。従って、筐体にカード抜け防止用の蓋等を設置 してください。その場合、カードロック状態でのカードと蓋等の隙間は0.3mm以下にしてください。

The card is dropped while having engaged or the impact is added and the card comes off to this item though a simple lock for the card omission prevention is installed in the cam slider. Therefore, please set up the lid for the card omission prevention etc. in the enclosure. In that case, please adjust the spaces such as cards and lids in the state of the card lock to 0.3 mm or less.

8-2. 半田付け後の洗浄

Washing after soldering

本品を半田付け後に洗浄をする場合は、半田付け部のみ部分的に洗浄を行ってください。 ジャブ漬け等の洗浄をした場合は、カードの挿入、抜去が困難になる場合が有ります。

Please wash only the soldering part partially when washing after this item is soldered. When a whole soaking etc. are washed, the insertion and extraction of the card might become difficult.

8-3. カードの挿入

Card insertion

miniSDソケットにはminiSDカード以外のものを挿入しないでください。また、miniSDカードも 正規方向以外では挿入しないでください。

Please don't insert anything except miniSD card into this item. And please don't insert miniSD card in irregular directions.

8-4. 筐体への組み込み後、本品に直接大きな振動及び負荷等が加わらないように、取り付け基板に 固定対策をしてください。

After assembling this item in the case, they shall be fastened to PCB where they are mounted so that they are free from direct excessive vibration and force.

8-5. 本品のコンタクト部には触れないで下さい。

Contacts of this item shall be kept from human touch.

8-6. カード飛び出し

Card ejection

本品はカード飛び出し制御機能を有していません。従って、カード排出時、カードを押している指 又は冶具等をカードから急に離すと、本品からカードが飛び出しますので、十分ご理解の上ご使用 下さい。

Please use caution when ejecting the card from the connector. The connector doesn't have the card ejection control function. When pushing the card, the spring force could cause the card to pop out and project from the connector if finger or slip pushing the card is removed improperly.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	С	SEE SHEET 1 OF 14	MINISD SOCKET ((NORMAL 7) THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION	FYPE) <u>製品仕様</u>		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOC		NUMBER		FILE NAME	SHEET	
PS-500972-001				SEE SHEET 1 OF 14	12 OF 14	
			·	EN-3	37-1(019)	

LANGUAGE



PRODUCT SPECIFICATION



JAPANESE ENGLISH

8-7. 基板実装後に基板を直接積み重ねないように、注意して下さい。

After mounting of connectors, please care of not pile up on the PCB which mounted connectors directly.

8-8. FPCへの実装時及び実使用時の注意点

The notes when FPC is mounted and used really

半田付け部の未半田、本品の反り防止のために実装時及び実使用時はFPCの下または周辺に補強版を入れ、 コネクタを固定して下さい。製品性能が出ない場合があります。

For unsolder in soldering part and curvature prevention of a connector, the reinforcement version puts around the bottom of FPC at the time of mounting and real use, and it fixes a connector. The product performance might not go out.

8-9. カード無理抜き

Unreasonableness omission of card

カードがロックされた状態で、カードを無理に引き抜かないようにして下さい。 製品内部を破損する恐れがあります。

Where a card is lock within a connector, please do not draw out a card by force. There is a possibility of damaging a product core.

8-10.カード嵌合状態、あるいは、カード無理抜き等によるカムスライダーをロックした状態にて、 リフロー等、加熱はしないで下さい。加熱によるストレスにより、カードロック機構は破損する恐れが あります。

Please do not apply heat while the card is locked inside of the product or cam slider is still locked position by forced withdrawal of card. The heat stress may cause to the damage card lock mechanism.

8-11.半田付け部の未半田は、ターミナル脱落、ターミナル間ショート、ターミナル座屈、また、 コネクタの基板からの外れが懸念されます。従って、全ての半田付け部(計17ヶ所)に半田付けを 行って下さい。

As for the unsolder of the solder part are anxious about terminal omission, short-circuit between terminals, terminal bend, and the blank from the PCB of a connector. Therefore, please solder to all solder parts (total of 17 places).

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	С	SEE SHEET 1 OF 14	miniSD SOCKET ((NORMAL 1		書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	1011351010
DOC				FILE NAME	SHEET
PS-500972-001				SEE SHEET 1 OF 14	13 OF 14
				EN-3	37-1(019)





LANGUAGE

REV.		REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRTTN:	CH'K:
А		RELEASED	·04/07/14	J2005-0188	K.YAMANE	M.YAGI
В		REVISED	·04/10/26	J2005-1246	K.YAMANE	K.ADACH
С		REVISED	'05/09/13	J2006-0835	K.YAMANE	K.ADACH
		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	F		miniSD SOCKET CONNECTOR			
	С	SEE SHEET 1 OF 14	(NORMAL TYPE) 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER					FILE NAM	E SHEE
	PS	6-500972-001			SEE SHEET 1 O	^{F 14} 14 OF